

# 2026年3月期 第3四半期 (2025年10月～12月) 東京エレクトロン 決算説明会

2026年2月6日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 (常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー)
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 (代表取締役社長・CEO)



# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。



# 2026年3月期 第3四半期 連結決算の概要

2026年2月6日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー  
川本 弘



# 損益状況（四半期）

(億円)

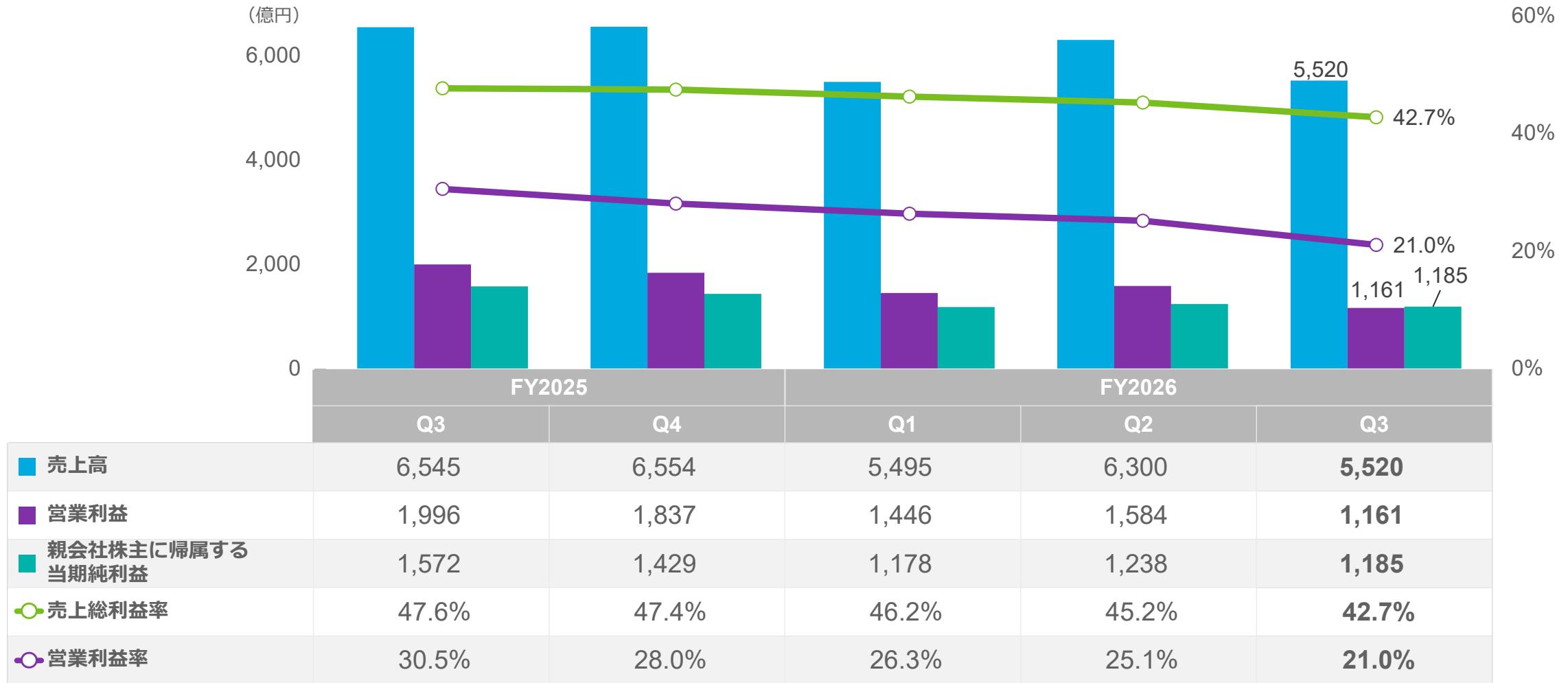
	FY2025		FY2026		Q3	vs. FY2026 Q2	vs. FY2025 Q3
	Q3	Q4	Q1	Q2			
売上高	6,545	6,554	5,495	6,300	5,520	-12.4%	-15.7%
売上総利益	3,117	3,105	2,539	2,848	2,358	-17.2%	-24.4%
売上総利益率	47.6%	47.4%	46.2%	45.2%	42.7%	-2.5pts	-4.9pts
販管費	1,121	1,267	1,092	1,264	1,196	-5.3%	+6.7%
営業利益	1,996	1,837	1,446	1,584	1,161	-26.7%	-41.8%
営業利益率	30.5%	28.0%	26.3%	25.1%	21.0%	-4.1pts	-9.5pts
税金等調整前当期純利益	2,001	1,851	1,519	1,610	1,533	-4.8%	-23.4%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,572	1,429	1,178	1,238	1,185	-4.3%	-24.6%
研究開発費	618	727	621	726	662	-8.9%	+7.2%
設備投資額	502	346	528	912	303	-66.7%	-39.6%
減価償却費	160	183	171	191	211	+10.6%	+31.7%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

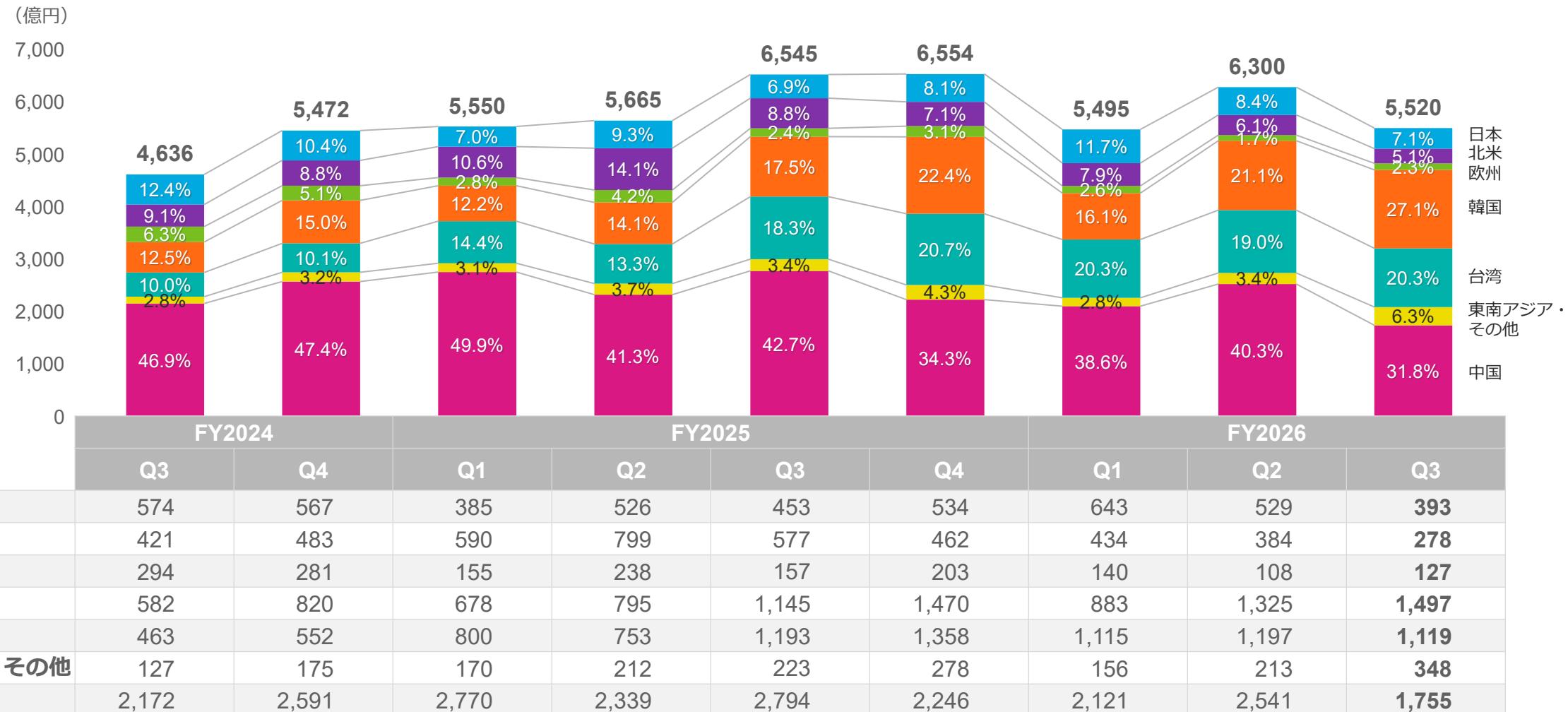
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

3. FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています。FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。

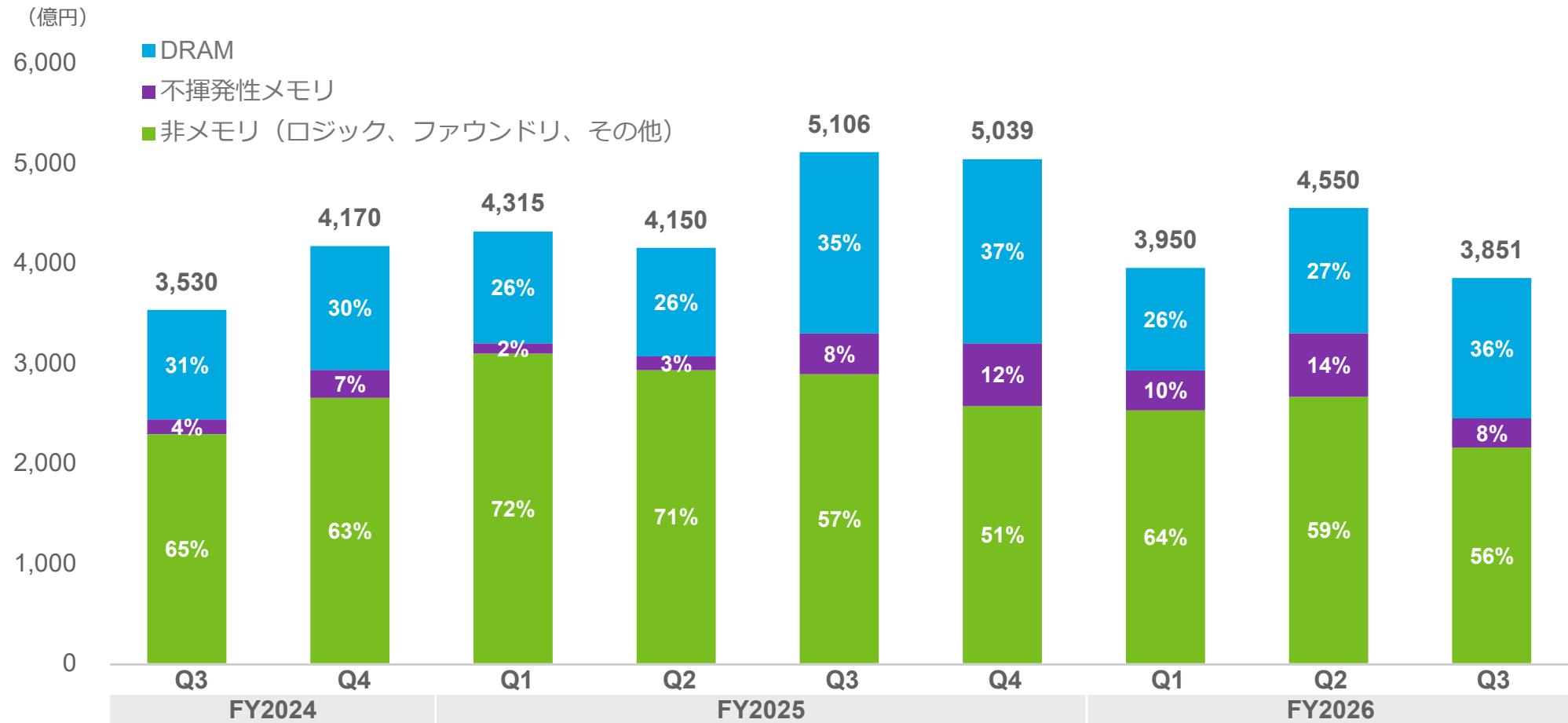
# 損益状況（四半期）



# 地域別売上高構成比（四半期）



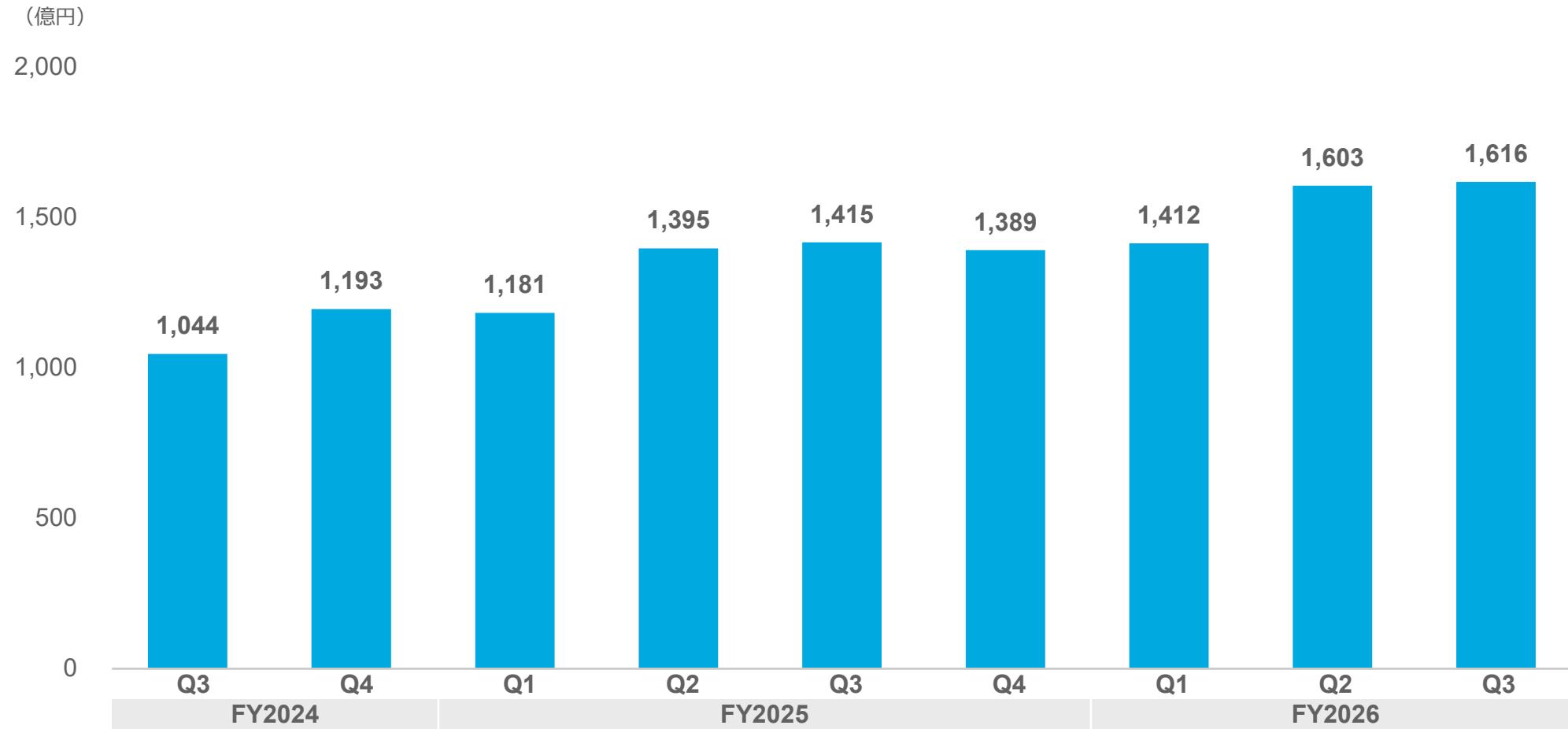
# SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



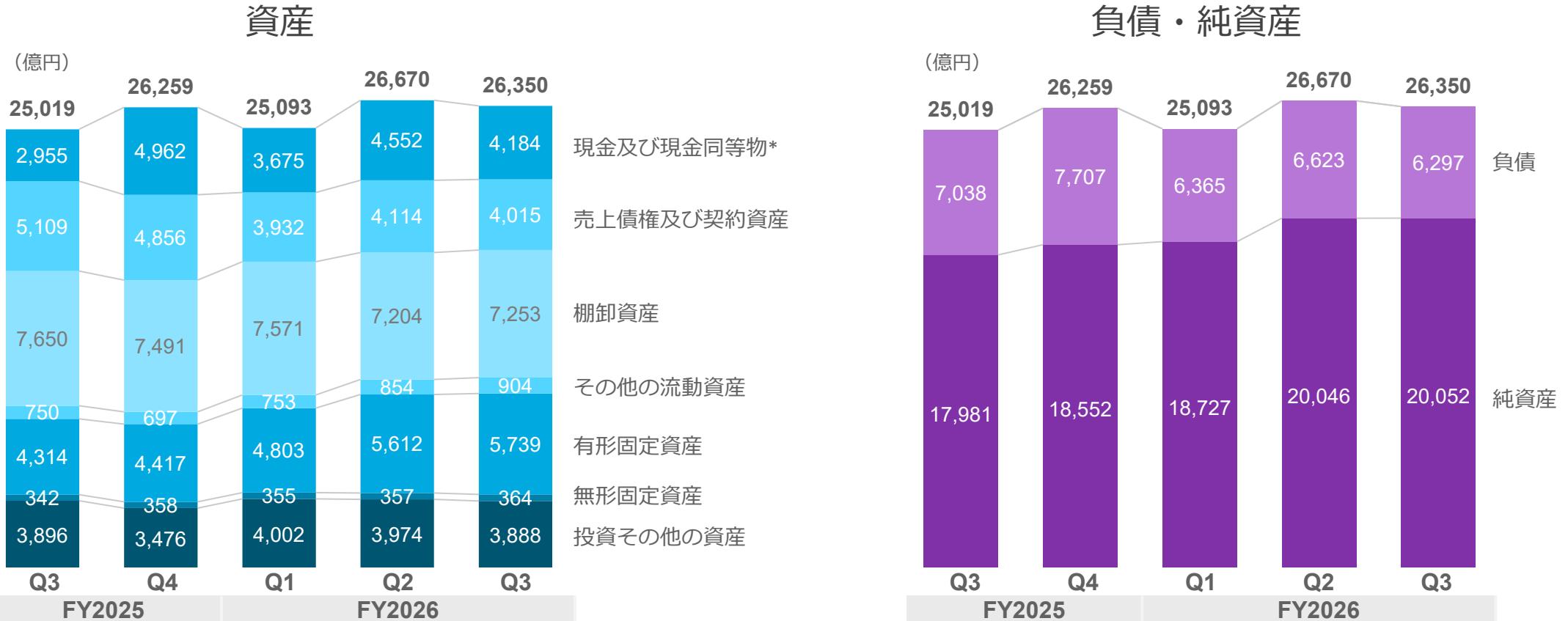
1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置

2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

# フィールドソリューション売上高（四半期）

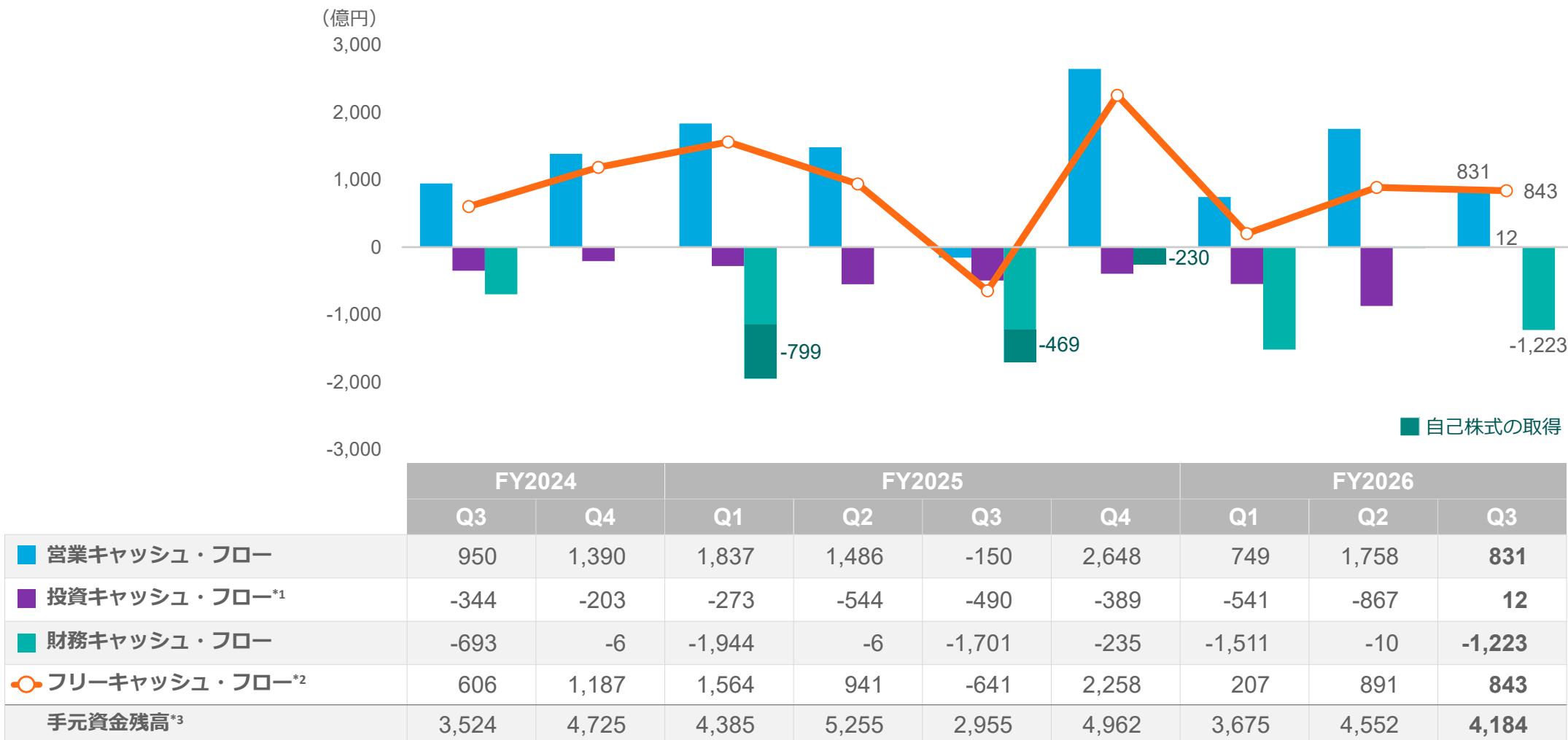


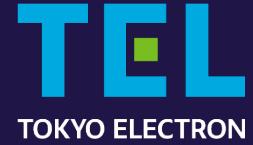
# 貸借対照表（四半期）



\*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

# キャッシュ・フロー（四半期）





# 事業環境および業績予想

2026年2月6日

代表取締役社長・CEO  
河合 利樹



## 事業環境 (2026年2月時点でのWFE市場の見方)

- CY2026 : 15%以上の成長を見込む
  - AIサーバー向け半導体需要の急速な拡大に伴い、先端ロジックとDRAM投資が大幅に増加
  - 変動要因 : 顧客工場のクリーンルームスペース、納期（部材供給、労働力）、為替など
- 今後も旺盛なAIアプリケーション需要に牽引され、先端半導体向け投資は中長期的に拡大傾向が続くと見込む
  - DRAM : HBMのみならず汎用DRAM向け投資も急増。投資前倒し要求も強い
  - NAND : SSD向け需要が急増。稼動率も上昇し新規投資につながる勢い
  - ロジック/ファウンドリ : 先端向け投資は今後もさらに増加。  
アドバンストパッケージングも進展
  - 成熟世代デバイス : 現状と同規模程度のWFEが継続すると予測

付加価値の高い最新装置の需要拡大を見込む

# 先端エリアで拡大する事業機会

\* POR (Process of Record)

:顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

エッチング	<ul style="list-style-type: none"><li>・HBM配線工程POR、キャパシタ工程 大手POR独占 (DRAM)</li><li>・Slit工程、チャネルホール工程 POR (NAND)</li><li>・アドバンストパッケージ向け POR (ロジック)</li></ul>
塗布現像	<ul style="list-style-type: none"><li>・メタルオキサイドレジスト対応 究極のウェット現像技術評価進捗</li><li>・新製品CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™リリース</li></ul>
成膜	<ul style="list-style-type: none"><li>・アドバンストパッケージ向けキャパシタHigh-k POR (ロジック)</li><li>・埋め込み膜用 枚葉プラズマCVD 評価開始 (ロジック)</li><li>・新低抵抗メタルワードライン工程POR (NAND)</li></ul>
洗浄	<ul style="list-style-type: none"><li>・次世代超臨界装置、複数顧客において評価開始 (DRAM)</li><li>・レジスト剥離 複数顧客で評価中、1社POR獲得済 (ロジック/メモリ)</li><li>・バッチ+枚葉のハイブリッド装置評価開始 (ロジック/メモリ)</li></ul>
プローバ	<ul style="list-style-type: none"><li>・AI/HPC向け先端Logicで市場を席捲。プローバ全体でFY2027売上1,000億円超</li><li>・ダイプローバ、複数顧客で評価開始。4月リリース予定</li></ul>
ボンダー / レーザー	<ul style="list-style-type: none"><li>・ボンダー : HBM薄化向け、NANDメモリセル+周辺回路、ロジック裏面配線、アドバンストパッケージ向け POR</li><li>・レーザーリフトオフ・トリミング、複数顧客にてプロセス評価進捗</li><li>・ボンダー/レーザー売上 今後5年で5,000億円以上を見込む</li></ul>
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"><li>・エッチング シェア80%以上、IT OLED向け高付加価値製品投入</li></ul>

先端アプリケーション装置における展開とともに、  
AI関連需要によるフィールドソリューションの事業機会も拡大

## 事業進捗

- 生産性と環境性能を向上させる新製品2種リリース
  - CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro DICE™:  
世界最高クラスの生産性と革新的な欠陥制御技術を備えた最新鋭の塗布現像装置
  - EVAROS™:  
最大処理能力200枚、高精度・高品質な成膜コントロールを叶えたCVD/ALD装置
- Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2026受賞
  - 高度な発明を継続的に生み出していることが評価され、5年連続 6度目の受賞
  - 半導体製造装置業界で世界1位を誇る保有特許件数：26,029件（2025年末時点）

革新的で付加価値の高い独自の技術を継続的に創出するべく、  
積極的な研究開発投資を実施

# 2026年3月期 業績予想

(億円)

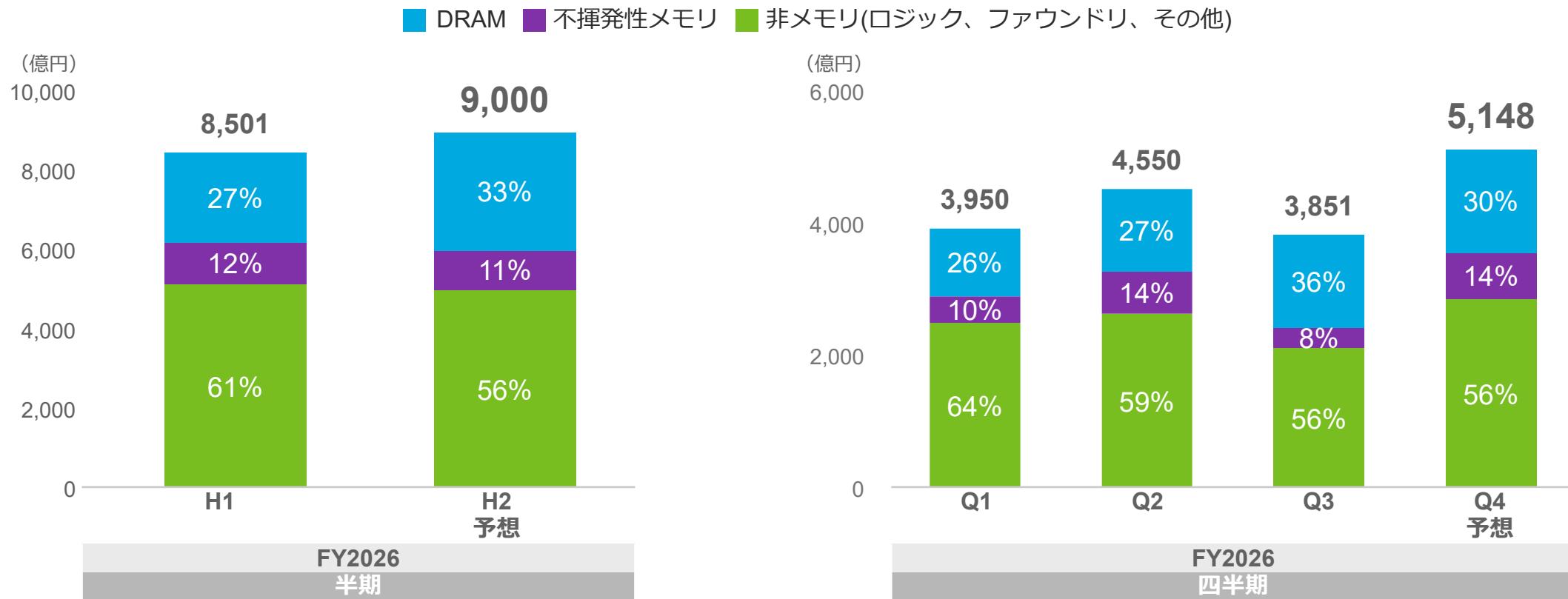
	FY2025 (実績)	FY2026					ご参考：FY2026 10/31時点予想	
		H1 (実績)	H2 (新予想)	通期 (新予想)	vs FY2025	通期修正額*	H2	通期
売上高	24,315	11,796	12,303	24,100	-0.9%	300	12,003	23,800
売上総利益	11,462	5,388	5,531	10,920	-4.7%	130	5,401	10,790
売上総利益率	47.1%	45.7%	45.0%	45.3%	-1.8pts	-	45.0%	45.3%
販管費	4,489	2,357	2,632	4,990	+11.1%	60	2,572	4,930
研究開発費	2,500	1,348	1,551	2,900	+16.0%	-	1,551	2,900
研究開発費以外の販管費	1,989	1,009	1,081	2,090	+5.1%	60	1,021	2,030
営業利益	6,973	3,031	2,898	5,930	-15.0%	70	2,828	5,860
営業利益率	28.7%	25.7%	23.6%	24.6%	-4.1pts	-	23.6%	24.6%
税金等調整前当期純利益	7,061	3,129	4,010	7,140	+1.1%	790	3,220	6,350
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	2,416	3,083	5,500	+1.1%	620	2,463	4,880
1株当たり当期純利益 (円)	1,182.40	527.31	-	1,200.05	+17.65	135.28	-	1,064.77

\* 2025年10月31日に発表した通期業績予想からの修正額を示しています。

力強い事業環境を踏まえ、通期の業績予想を上方修正。  
政策保有株式の追加売却に伴う特別利益も反映

# 2026年3月期 SPE新規装置売上予想

## アプリケーション別売上構成比



\* グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

FY2026 H2のSPE新規装置売上予想を9,000億円に更新。  
Q4の新規装置売上はQ3比 +30%以上を見込む

# 2026年3月期 研究開発費・設備投資計画

宮城 第3開発棟  
エッチング装置



宮城県黒川郡  
2025年4月 竣工

東北生産・物流センター  
成膜装置



岩手県奥州市  
2025年11月 竣工

熊本 プロセス開発棟  
コータ/デベロッパ、洗浄装置

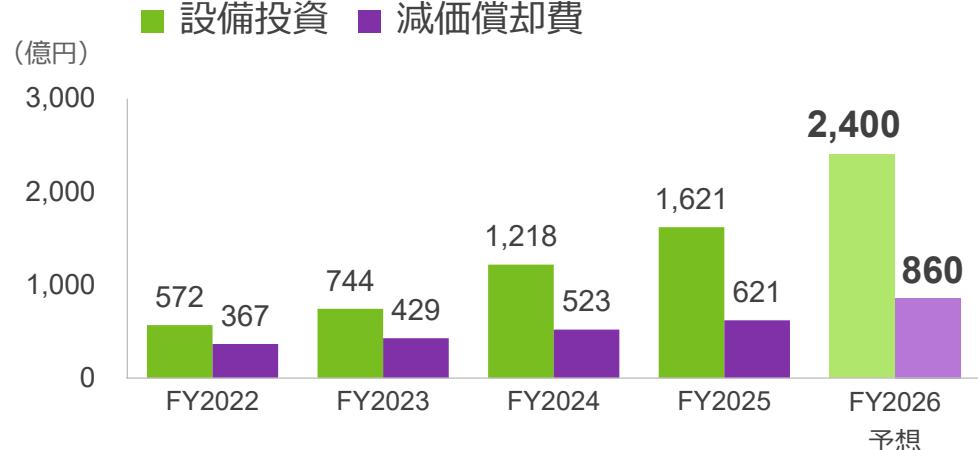
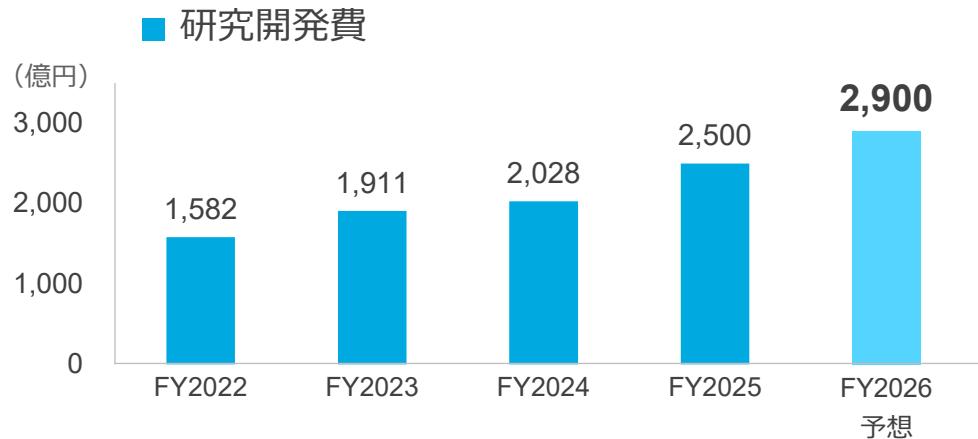


熊本県合志市  
2025年10月 竣工

宮城生産革新センター  
エッチング装置



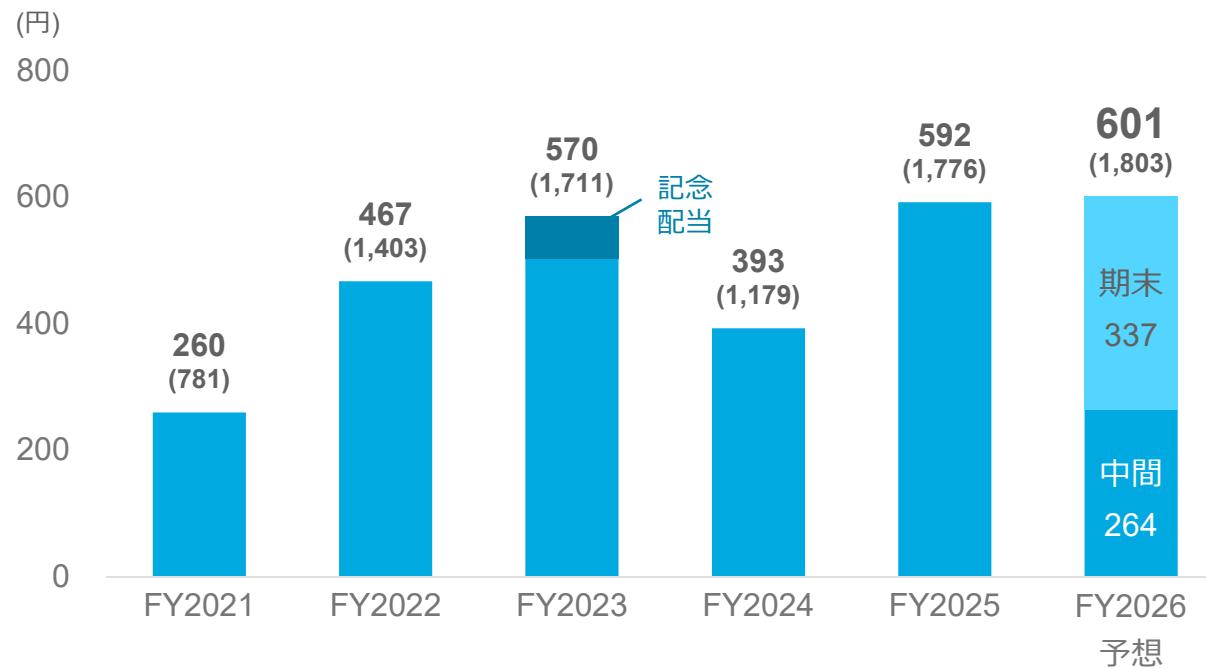
宮城県黒川郡  
2027年夏 竣工予定



半導体の技術革新を支える対応力と急速な需要拡大に応える生産能力を確立。  
今後の収益機会を着実に捉え、企業価値の最大化を目指す

# 2026年3月期 配当予想

## 1株当たり配当金



- FY2021～2023の1株当たり配当額は、FY2021の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

## 当社の株主還元策

### 連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金50円\*を下回らない  
2期連続して当期利益を生まなかつた場合は、配当金の見直しを検討する

### 自己株式の取得： 機動的に実施を検討

\*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

1株当たり通期配当予想は過去最高の601円に上方修正

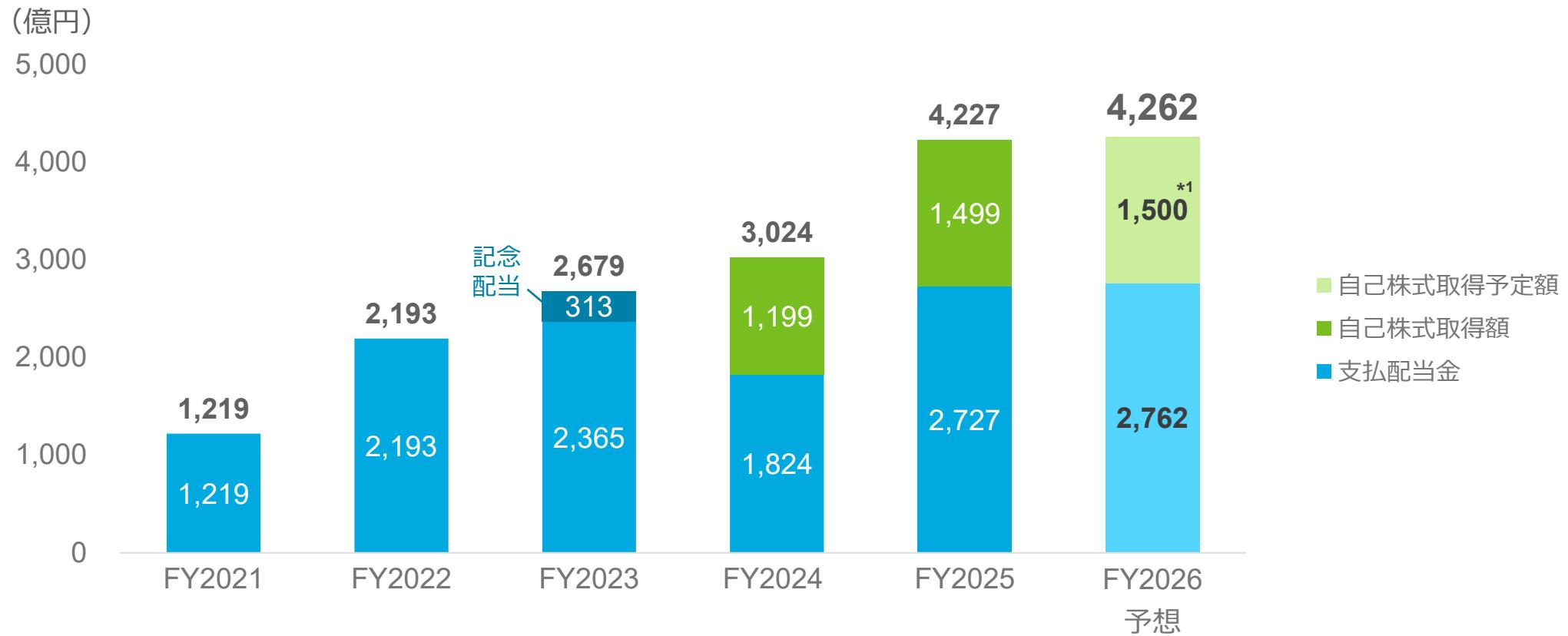
## 自己株式の取得について

### 最大1,500億円の自己株式取得を予定

- 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 : 750万株（上限）  
(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 1.6%)
- 株式の取得価額の総額 : 1,500億円（上限）
- 取得する期間 : 2026年2月9日～2026年3月31日

拡大する当社の事業機会とキャッシュ創出力、資本効率の向上を考慮し、  
今後も適切なバランスシート・マネジメントを実施

# 総還元額



自己株式取得と合わせ、過去最高の総還元額を見込む

The logo consists of the letters 'TEL' in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'E' is unique, featuring a small green square centered in its vertical stroke.

TEL

TOKYO ELECTRON

# ご案内：東京エレクトロン主催スマート会議

機関投資家・アナリスト向け

2026年3月期第3四半期決算説明会のフォローアップセッション

- 日時：

- 日本語： 2026年2月19日(木) 10:30 - 11:30 (日本時間)
- 英語： 2026年2月20日(金) 8:00 - 9:00 (日本時間)

- スピーカー：

- IR室グローバルヘッド 八田浩一、室長 高木純子

- 形式：

- ウェビナー

- 事前登録ページ：

- [https://app.msetsu.com/stocks/8035/ir\\_events](https://app.msetsu.com/stocks/8035/ir_events)

